

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-006

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币13亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2023年度股东大会审议通过。

近日，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）同意给公司授信额度为人民币5,000万元（含续授信），期限12个月，由实控人赵积清先生（免配偶）、惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保，公司以销售形成的应收账款提供质押担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与浦发银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013221158XC

注册资本：2,935,208.0397万人民币

成立日期：1992年10月19日

住所：上海市中山东一路12号

经营范围：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币

92,846.80万元，涉及的累计担保为人民币79,546.8万元，本次融资事项在2023年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

浦发银行综合授信合同及相关文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年2月21日